

证券代码：688603

证券简称：天承科技

上海天承科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场调研 ☐电话会议 ☐其他
参会单位	通过上证路演中心参与“关于参加 2025 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告”的投资者
调研时间	2025 年 11 月 13 日（周四）15:00-16:00
会议地点	上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：童茂军 董事会秘书、副总经理：费维 财务负责人：王晓花 独立董事：石建宾
投资者关系活动主要内容记录	网络文字互动问答 （一）面对复杂恶劣的外部环境，公司接下来如何维持相对稳定的业绩增长？ 答复： 尊敬的投资者您好，过去十余年，公司通过不断自主研发和下游推广，成功从外资垄断中突围，获得了行业 and 客户的广泛认可，目前已成为国内高端沉铜、水平电镀技术的牵头企业。未来，公司将继续以高端 PCB、封装基板、半导体先进封装等领域关键材料为核心，在持续强化市场拓展能力的同时，积极巩固现有市场优势，通过优化产品销售结构，不断提升高价值产品的销售占比，进一步夯实市场竞争力。感谢您的关注！ （二）请问公司明年业务方面是否有新的战略规划？

	答复： 尊敬的投资者您好，公司明年将以高质量发展为战略目标，全面提升经营管理水平，从多个维度提升企业竞争力：持续强化市场拓展能力的同时，通过提升高价值产品的销售占比，优化公司收益率；持续加大产品研发投入，专注于技术创新与突破，依托丰富的产品矩阵和全面的服务解决方案，有效满足多元化市场需求；深入推进精细化管理，通过优化资源配置、引入智能制造、强化成本控制，实现降本增效；积极布局海外市场，推动泰国工厂的建设进度，提升公司海外市场影响力；持续引入国内高端技术人才，在上海集成电路集中地设立总部和研发中心平台，积极优化现有核心产品并开发新配方，不断拓展半导体、显示面板、新能源等新领域的产品应用。 公司将以高端 PCB、集成电路等相关电子化学品双轮驱动，推动公司规模与产品力持续增长变强，力争成为专用功能性湿电子化学品领域的行业领军品牌。感谢您的关注！ （三）了解到公司产品在不断升级，请问产品升级的方向主要是什么？ 答复： 尊敬的投资者您好，天承科技始终以自主研发为根本，抓紧产业升级和国际化的新机遇。产品升级的方向主要围绕下游行业高性能计算和人工智能发展趋势、以及 PET、ABF、玻璃基板、M9 新材料以及先进封装新工艺等的需求展开。公司将不断探索前沿工艺的融合发展，持续创新提升核心竞争力，打破行业垄断并提供“进口替代”的新方案，感谢您的关注！
附件清单	无
日期	2025 年 11 月 14 日